

Strati: 2

Materiale: FR4

Spessore finito: 1.57mm + \-10%

Strato esterno spessore di rame: 1oz

Finitura: ENIG (Au:2-5u \"

Soldermask (colore): Entrambi i lati, LPI (nero)

Serigrafia (colore): Entrambi i lati, bianco

Test elettrico

FINITURA: QUESTA SCHEDA DEVE ESSERE IMMERSIONE ORO PLACCATO SECONDO IPC-6012.
SPESSORE deve essere .050uM sopra 3-6uM nichelatura.

PIASTRA DI RAME FORI MINIMO.025 MEDIO,.020 MIN... FORI POTREBBERO NON ESSERE COLLEGATI, AD ECCEZIONE DI VIAS,500 FINITURA O PIÙ PICCOLI.

Chiave layer:

=====

*. GM4: Profilo di scheda

*. TXT: File NC Drill

*. GTP: Top incolla

*. GTO: Top Silkscreen

*. GTS: Soldermask superiore

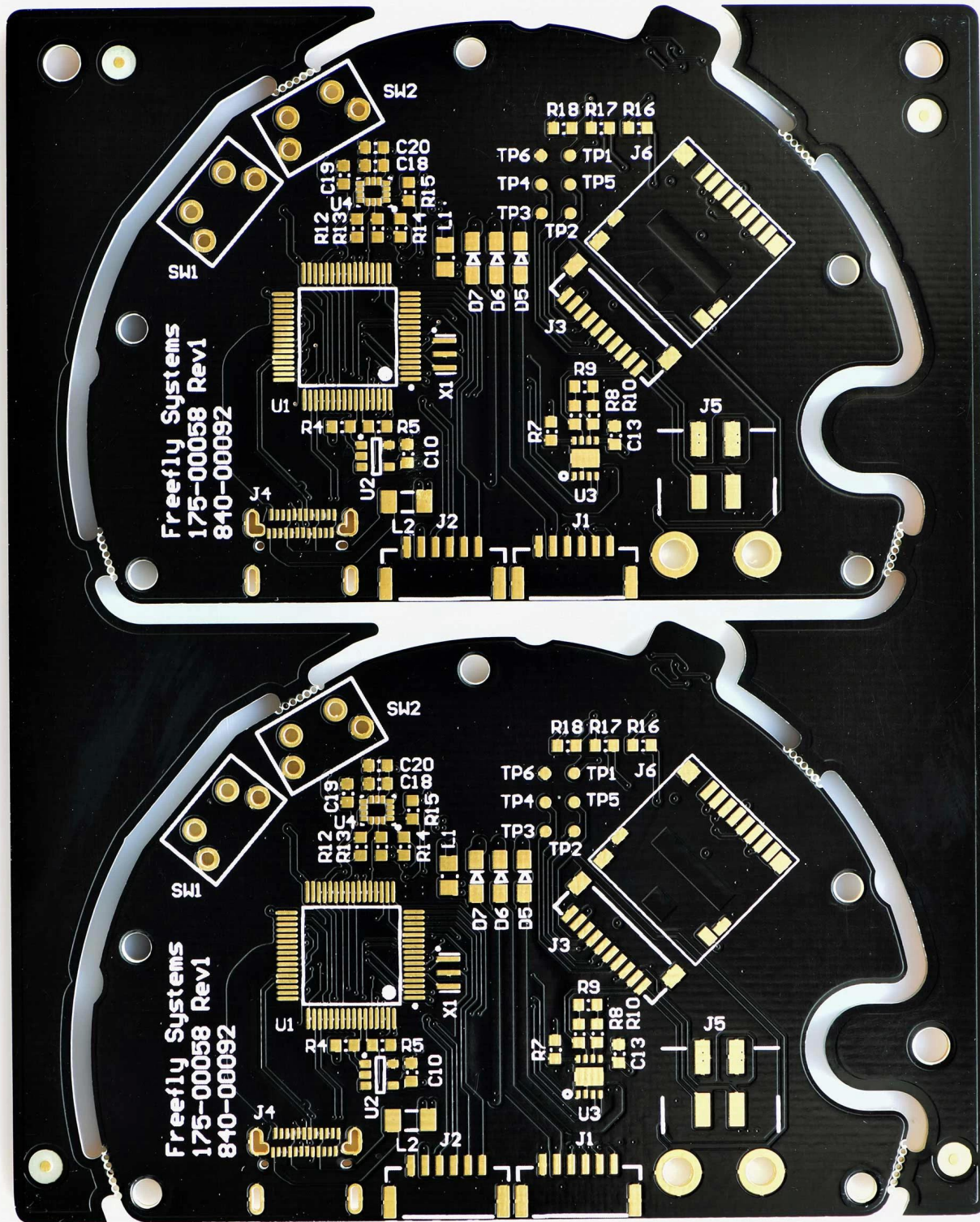
*. GTL: Strato di rame superiore

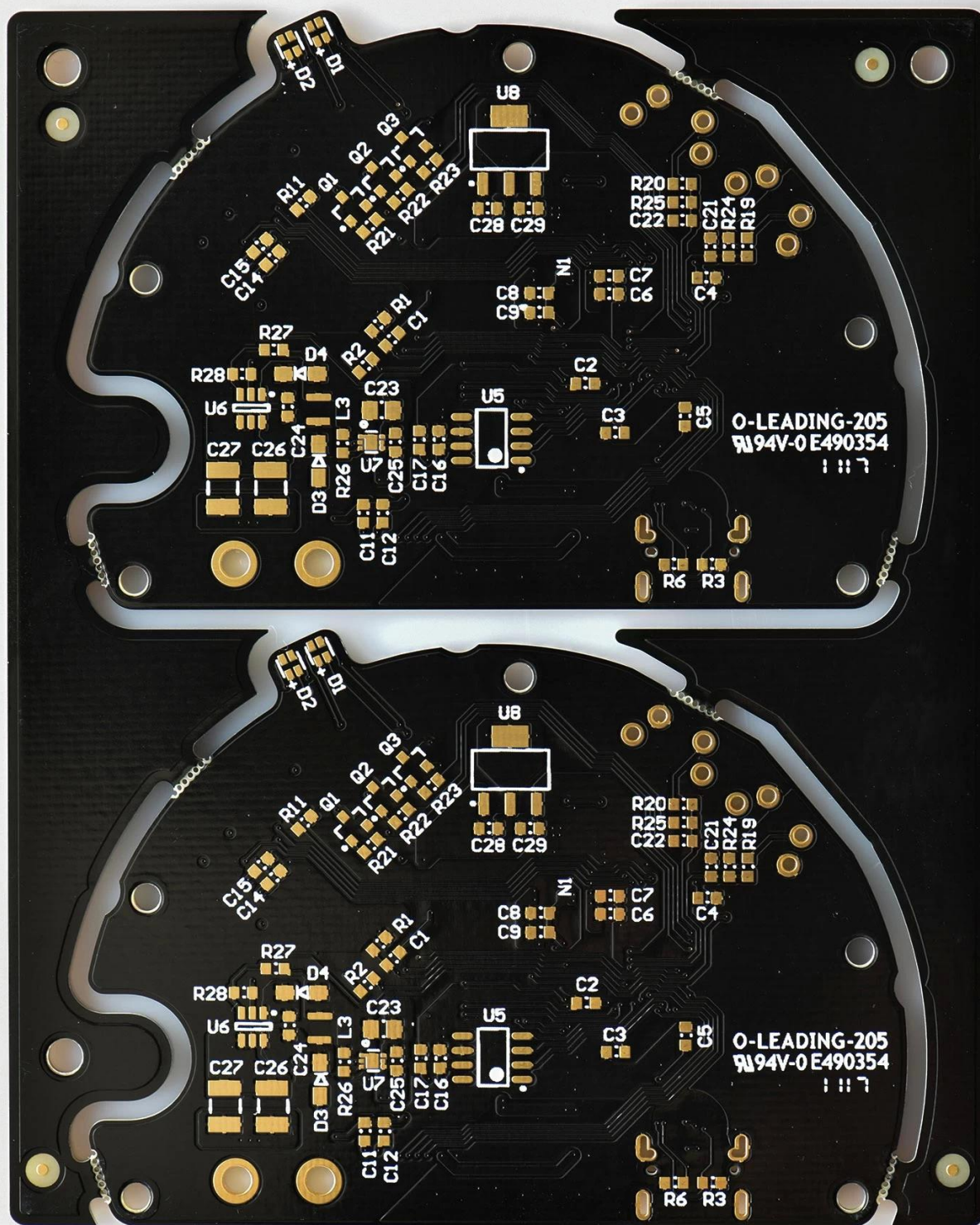
*. GBL: Basso strato di rame

*. GBS: Bottom Soldermask

*. GBO: Fondo Silkscreen

*. GBP: Pasta di fondo





Il doppio ha parteggiato fornitore di pcb, giallo serigrafia pcb fornitore